附件5：

珠海高新区2024年度集成电路产业人才

申报指南

一、申报资格

**（一）市级产业人才**

1. 在我区集成电路企业工作；

2. 已评定为“珠海市英才计划”的顶尖、一类、二类、三类高层次人才。

**（二）区级产业人才**

1. 遵纪守法，诚实守信、具有良好的职业道德；

2. 全职在我区集成电路企业或公共服务平台工作；

3. 以申报起始时间往前算起，依法在我区连续缴纳3个月社会保险或工资薪金个人所得税，且与用人单位签订3年以上全职劳动合同；

4. A类产业人才年龄在法定退休年龄以下（有特别突出贡献者，年龄条件可适当放宽），B类产业人才年龄在50周岁以下，C类产业人才年龄在40周岁以下。

5. 且符合以下A类、B类、C类资格条件之一：

**A类（满足其一）**

（1）在集成电路设计、制造、封测、装备、材料等子行业全国前10大公司内从事研发、生产等相关部门的技术岗位累计工作5年以上者，2023年年薪不低于80万元；

（2）在集成电路设计、制造、封测、装备、材料等子行业全球前25大公司内从事研发、生产等相关部门的技术岗位累计工作3年以上者，2023年年薪不低于80万元；

（3）在集成电路材料（硅片、光罩材料等）、电子设计自动化（EDA）工具软件、IP核开发全球前10大公司内从事研发、生产等相关部门的技术岗位累计工作3年以上者，2023年年薪不低于80万元；

（4）取得博士学位后在集成电路产业企业或相关研究机构从事研发、生产等相关部门的技术岗位累计工作3年以上，并曾作为技术团队核心成员参与核心技术攻关或曾任职一级以上业务部门负责人者，2023年年薪不低于80万元；

（5）取得“双一流”高校正教授资格且从事集成电路行业相关科研岗位累计工作3年以上者，2023年年薪不低于80万元；

（6）在集成电路设计、制造、封测、装备、材料等子行业公司内从事研发、生产等相关部门的技术岗位累计工作8年以上者，2023年年薪不低于100万元。

**B类（满足其一）**

（1）在集成电路设计、制造、封测、装备、材料等子行业全国前10大公司内从事研发、生产等相关部门的技术岗位累计工作3年以上者，2023年年薪不低于40万元；

（2）在集成电路设计、制造、封测、装备、材料等子行业全球前25大公司内从事研发、生产等相关部门的技术岗位累计工作2年以上者，2023年年薪不低于40万元；

（3）在集成电路材料（硅片、光罩材料等）、电子设计自动化（EDA）工具软件、IP核开发全球前10大公司内从事研发、生产等相关部门的技术岗位累计工作2年以上者，2023年年薪不低于40万元；

（4）取得博士学位，所学专业学科门类为理学、工学，且从事集成电路研发、生产等相关部门的技术岗位者，2023年年薪不低于40万元；

（5）取得国家一级职业资格证书或高级职称的专业技术人才，且从事集成电路研发、生产等相关部门的技术岗位累计工作3年以上者，2023年年薪不低于40万元；

（6）取得全日制硕士研究生学位，所学专业学科门类为理学、工学或相关国家部委支持（筹备）建设示范性微电子学院的硕士学位，且从事集成电路研发、生产等相关部门的技术岗位累计工作3年以上者，2023年年薪不低于40万元；

（7）在集成电路设计、制造、封测、装备、材料等子行业公司内从事研发、生产等相关部门的技术岗位累计工作5年以上者，2023年年薪不低于50万元。

**C类（满足其一）**

（1）取得国家二级以上职业资格证书的技术类或国家一级职业资格以上的管理类人才，且从事集成电路产业领域相关工作累计2年以上者，2023年年薪不低于20万元；

（2）取得全日制硕士研究生学位的应届毕业生，且从事集成电路研发、生产等相关部门的技术岗位者，2023年年薪不低于20万元；

（3）取得全日制学士学位以上，所学专业学科门类为理学、工学，且从事集成电路研发、生产等相关部门的技术岗位累计工作2年以上者，2023年年薪不低于20万元；

（4）取得“双一流”大学全日制学士学位以上，所学专业学科门类为理学、工学，且从事集成电路研发、生产等相关部门的技术岗位者，2023年年薪不低于20万元。

二、申报材料

**（一）市级产业人才**

1. 珠海高新区集成电路产业人才申报书（附件6）；
2. 申报人有效身份证明材料：

（1）境内居民提供居民身份证正反面扫描件；

（2）港澳台人才提供《港澳居民来往内地通行证》或《台湾居民来往大陆通行证》正反面扫描件；

（3）外籍人才提供有效护照正反面扫描件；

1. 珠海市高层次人才公示文件、英才卡等证明材料（扫描件加盖单位公章）。

**（二）区级产业人才**

1. 珠海高新区集成电路产业人才申报书（附件6）；
2. 申报人有效身份证明材料：

（1）境内居民提供居民身份证正反面扫描件；

（2）港澳台人才提供《港澳居民来往内地通行证》或《台湾居民来往大陆通行证》正反面扫描件；

（3）外籍人才提供有效护照正反面扫描件。

1. 申报人与企业签订的三年以上全职劳动合同复印件与《就业及社保查询情况》证明材料；
2. 申报人最高学历、学位证书，海外学位需同时提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书（复印件加盖单位公章扫描件）；
3. 申报人在2019年1月1日至今的完整社保记录及个人所得税纳税记录（社保记录和个税记录请到相关官网下载并加盖单位公章后扫描）；
4. 申报人职称和职业资格等级证书（复印件加盖单位公章扫描件）；
5. 申报人2023年的年薪证明材料：

①加盖公章的“2023年全年度个人所得税APP完整截图文件（申报人签字确认）”，或加盖公章的“自然人电子税务局（扣缴端）导出的《综合所得明细表》（需显示年度汇总金额，导出路径：首页—查询统计—个人扣缴明细查询—导出）”，

②中华人民共和国个人所得税纳税记录（原《税收完税证明》）；

1. 申报人符合区级A、B、C三类产业人才工作年限要求的证明材料（复印件加盖单位公章扫描件）；
2. 申报人符合相关规定的其他资格条件及能证明所在企业实力、自身能力水平的其他材料，如企业介绍、企业荣誉证书、个人荣誉证书、获奖证书、论文著作发表情况、科研成果、专利授权情况或专利申请情况、新产品/新工艺/新技术/材料研发情况、自主产权情况、荣誉证书、工作证明、离职证明、项目负责情况材料、任职情况证明等材料（复印件加盖单位公章扫描件）。

三、补充说明

（一）集成电路设计、制造、封测、装备、材料等子行业全国前10大公司或全球前25大公司排名，集成电路材料（硅片、光罩材料等）、电子设计自动化（EDA）工具软件、IP核开发全球前10大公司排名，以国际级研究机构IC Insights、Trendforce、Gartner.IDC或IHS、中国半导体行业协会等同类机构最新年度发布为准。在与上述排名实力相当的企业（由申报人提供企业实力证明材料）就职的人才，经区主导产业发展工作领导小组办公室审定后，其工作年限可并入该条款提及的“累计工作年限”。

（二）本指南提及的“2023年年薪”指申报人2023年在高新区用人单位工作期间取得与任职或者受雇有关的收入，即根据《中华人民共和国所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第707号）第六条规定的工资、薪金所得，包括个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。“工资、薪金”不含：个体工商户的生产、经营所得；对企事业单位的承包经营、承租经营所得；劳务报酬所得；稿酬所得；特许权使用费所得；利息、股息、红利所得；财产租赁所得；偶然所得等。

（三）专业学科门类、职称、职业资格等认定标准以国家相关部委发布的最新版名录为准。

四、其他事项

本申报指南由区科技产业局负责解释。